

HS-6002A/B LED 贴片有机硅封装硅胶 (SMD)

一、产品简介:

- 该产品系双组份有机硅封装材料, 此产品消泡性好、绝缘性能高、耐冷热冲击性好、抗 UV 性强、可以长期在-60℃~+200℃稳定工作。主要用于大功率 LED 透镜之填充。
- 产品特性及优点:
 - 优异的高温稳定性、在操作及性能上有更高的可靠性。
 - 湿气摄取量低。
 - 低离子含量。
 - 优异的光学特性。
 - 加成固化、无副产物收缩性小。
 - 无溶剂、无危害性散发物。

二、常规性能:

测试项目	测试方法/条件	HS-6002A	HS-6002B
外观	目测	无色透明液体	无色透明液体
粘度	40℃/mpa.s	1000	8000
密度	25℃/g/cm ³	1.00	1.00
保存期限	25℃室温通风	12个月	12个月

三、使用工艺:

项目	单位或条件	HS-6002A/B
混合比例	重量比	100: 100
可使用时间	25℃, /hrs	2hrs
固化工艺	℃/hrs	60℃/2hrs+150/4hrs
搅拌时间和温度	50℃以下/min	5~10
脱泡时间和温度	50℃以下/min	5~10

四、固化后特性:

项目	单位或条件	测试结果
硬度	shore-A	60~65
绝缘强度	25℃, kv/mm	>25
吸水性	25℃/24/hrs, %	< 0.1
体积电阻率	25℃, Ω, cm	1.0×10 ¹⁵
表面电阻率	25℃, Ω,	1.5×10 ¹⁵
拉伸强度	(Mpa)	10~15
透光率	(%)	98
延伸率	(%)	20
光折射率		1.50~152
Tg 值	℃	-125~130
导热系数	(wats/neter-℃)	0.3

五、储存、运输及注意事项:

此类产品属于非危险品, 按一般化学品运输。
室内 25℃以下储存在阴凉通风远离火源的区域。

六、包装规格:

A/B 500g 玻璃瓶。

七、性能测试环境:

以上性能数据为该产品测试环境温度湿度为 70%、温度为 25℃测试之数据, 仅供客户使用时参考, 并不能完全保证某个数据能完全达到全部所测数据, 请客户使用时以实测数据为准。